

**Теплоотвод для процессора
Intel® Pentium® 4 LGA775**

Руководство по установке

GH-ESB21-TH

Версия 1001
050916

Содержание

Комплект поставки.....	3
Спецификации.....	4
Основные особенности.....	4
Внимание!.....	5
Условия гарантии.....	5
Инструкции по установке теплоотвода на процессор P4 LGA775.....	6

Комплект поставки



(1) Теплоотвод
GH-ESB21-TH - 1



(2) Руководство по установке
GH-ESB21-TH - 1



(3) Термопаста - 1



(4) Винты - 4

Русский

Спецификации

- Размеры вентилятора: 92 x 92 x 38 мм
- Размеры радиатора: 86 x 123 x 71 мм
- Материал: ребра из экструзионного алюминия; радиатор из меди
- Регулировка частоты вращения: ШИМ и регулировка по температуре
- Разъем: 4-контактный
- Номинальное напряжение: 12 В
- Номинальный ток: 1.13 А (max)
- Воздушный поток: 91.71 куб.фут/мин. (max)
- Подшипники вентилятора: два шарикоподшипника
- Ожидаемый срок службы: 70 000 часов
- Общая масса: 1120 г
- Применение: Intel® Pentium® 4 LGA775

Основные особенности

- Соответствует спецификации теплоотводов Intel BTX Type I для форм-факторов Intel BTX и Micro BTX
- 5-см медная вставка с высокой теплопроводностью
- Полностью удовлетворяет требованиям Intel к регулировке частоты вращения методом ШИМ в зависимости от температуры процессора
- Имеет меньший уровень шума и большую эффективность, чем теплоотвод из комплекта поставки процессора
- Простая и быстрая установка

Режим работы вентилятора					
Температура воздуха на входе	25°C	25°C	25°C	35°C	35°C
Коэффициент заполнения при ШИМ	< 20%	50%	100%	< 20%	100%
Частота вращения вентилятора (об./мин.)	900	2350	3500	900	4500
Уровень шума (dBA)	19	35.2	45.9	19	51.2

Внимание!



Значения частоты вращения вентилятора являются приблизительными и приведены только для справки. Точные значения частот можно узнать, войдя в меню BIOS вашей системной платы.
Перед установкой теплоотвода удалите с его нижней поверхности защитную пленку.
Перед установкой теплоотвода убедитесь, что компьютер выключен, а блок питания отключен от сети.

Условия гарантии

Гарантия не распространяется на следующие случаи:

- Неправильное применение изделия или использование изделия не по назначению
- Использование изделия в условиях, не соответствующих рекомендуемым стандартам (в т.ч. в условиях разгона)
- Невозможность применения изделия из-за его несовместимости с системной платой
- Повреждение изделия другими компонентами
- Любая переделка изделия
- Использование неисправного изделия, приведшее к повреждению или выходу из строя других компонентов
- Повреждение в результате стихийных бедствий (в т.ч. землетрясений, пожаров и наводнений)
- Изделия с отсутствующей, поврежденной или неразборчивой гарантийной наклейкой

Поскольку теплоотвод имеет довольно большую массу, перед транспортировкой компьютера снимайте теплоотвод с процессора. Это позволит предотвратить возможные повреждения теплоотвода и возникновение проблем при последующей установке.

Русский

Инструкции по установке теплоотвода для P4 LGA775

Рис.1

Нанесите на поверхность установленного в разъем процессора равномерный слой термопасты.



Рис.2

Установите системную плату в корпус. Совместите крепежные отверстия теплоотвода GH-ESB21-TH с отверстиями на системной плате и установите теплоотвод на плату.



Перед установкой теплоотвода удалите с его нижней поверхности защитную пленку.



Рис.3

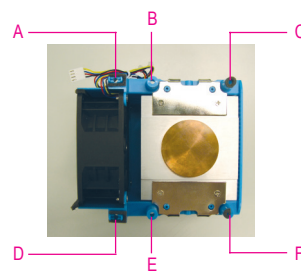
Закрепите теплоотвод винтами^(Замеч.). Убедитесь, что теплоотвод надежно прикреплен к системной плате и корпусу компьютера.



Рис.4

Подключите провод питания вентилятора теплоотвода к разъему CPU_FAN на системной плате.

(Замеч.) Теплоотвод можно закрепить с помощью 4 винтов двумя различными способами:
Вариант 1: A+C+D+F или Вариант 2: B+C+E+F



Русский

